

2023年5月15日

各位

住所 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
 会社名 ジオマテック株式会社
 代表者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎
 (コード番号 6907 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役執行役員兼CFO 河野 淳
 電話番号 045-222-5720

三井金属鉱業株式会社と協働で量産体制を整えている次世代半導体実装用 特殊キャリア「HRDP[®]」の設備投資による生産能力増強に関するお知らせ

当社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 松崎 建太郎)は、三井金属鉱業株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 納 武士、以下「三井金属」)が事業化を推進している次世代半導体実装用特殊キャリア「HRDP[®]※1」に薄膜を提供しております。

この「HRDP[®]」は、L/S = 2/2 μm以下の超高密度設計を実現できる特殊キャリアです。

現在三井金属では、複数の有力大手半導体メーカーの高い品質と需要に対応するため、「HRDP[®]」を適用した次世代半導体パッケージ開発が本格的に開始されております。このような状況を受け、当社は2025年稼働予定で赤穂工場に「HRDP[®]」用薄膜の生産能力増強を決定いたしました。

今回の設備投資は、2023年から2025年にかけて順次実施してまいります。

<取得資産の概要>

(1)事業所名(所在地)	赤穂工場(兵庫県赤穂市)
(2)主な設備の内容	薄膜用装置、付帯設備 他
(3)投資予定金額	900 百万円
(4)生産能力の変化	現生産能力の約2倍
(5)資金計画	借入・自己資金
(6)稼働予定時期	2025年

<業績への影響について>

2024年3月期の業績には影響いたしません。

当社は、今後とも三井金属向けに安定した品質と十分な供給能力の確保を図ってまいりますとともに、価値ある薄膜製品と加工技術を提供するプロフェッショナルとしての役割を果たしてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ

三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部
 TEL 03-5437-8028
 E-mail PR@mitsui-kinzoku.com

ジオマテック株式会社 TEL 045-222-5720
 E-mail ir_geomatec@geomatec.co.jp

【用語説明】

※1 High Resolution De-bondable Panel の略